

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte  
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail

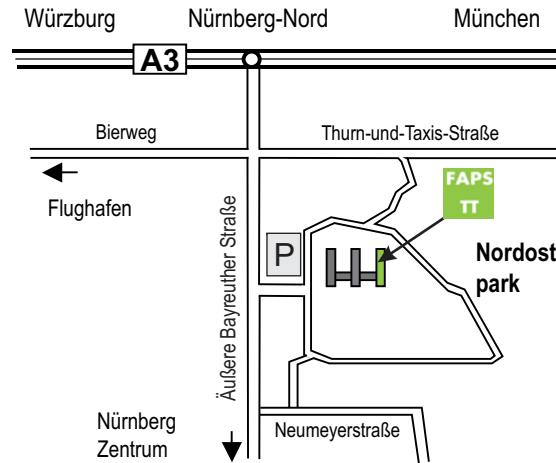
- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse
- per E-Mail an [service@faps-tt.de](mailto:service@faps-tt.de)
- per Fax an 0911 / 58058-77

Titel, Vorname, Name  
Firma  
Abteilung  
Straße, Hausnummer  
PLZ, Ort  
Telefon  
Telefax  
E-Mail  
Datum, Unterschrift

Ich melde mich an für das Fachseminar:  
**Innovationen in der Elektronikproduktion, 30.11.2011**

**Antwort**

FAPS-TT GmbH  
Fürther Straße 246  
90429 Nürnberg



**Veranstaltungsort:**

Das Seminar findet im „Forum im Park“ der  
Forschungsfabrik Nürnberg, Nordostpark 89, statt.

**Anmeldung:**

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit  
Vorlage der Anmeldebestätigung. Verwenden Sie bitte  
zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die  
Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt  
nach Eingangsdatum.

**Teilnahmegebühr und Leistungen:**

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 340,- € zzgl. MwSt. ist  
nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene  
Konto zu überweisen und schließt Tagungsunterlagen,  
Pausengetränke und Mittagessen mit ein.

**Rücktritt:**

Bei Rücktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben  
wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,- € zzgl. MwSt.  
Nach dieser Frist ist die Teilnahmegebühr gemäß  
Rechnung zu zahlen. Die Seminarunterlagen werden  
dann zugesandt.

**Weitere Informationen:**

FAPS-TT GmbH  
Sigrun Holzinger  
Telefon: 0911 / 58058-55; Telefax: 0911 / 58058-77  
E-Mail: [service@faps-tt.de](mailto:service@faps-tt.de)

**Ankündigung weiterer Veranstaltungen:**

- 07.03.2012: Mechatronische Produktentwicklung
- 18.04.2012: Mensch-Maschine-Interaktion
- 20.06.2012: MID-Gestaltungsworkshop

in Kooperation mit:



Fachseminar

**Innovationen in der  
Elektronikproduktion**

- Fertigungsprozesse
- Leistungselektronik
- Zukünftige Herausforderungen
- Referenten aus Industrie und Wirtschaft

**30. November 2011**

**Nürnberg**

Forum im Park  
Nordostpark 89

Fachliche Leitung:

Prof. Dr.-Ing. J. Franke,  
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung  
und Produktionssystematik

## Elektronikproduktion

Die fortschreitende Miniaturisierung elektronischer Bauelemente, die Einführung neuartiger Schaltungsträger und innovativer Verbindungstechnologien sowie die Produktion mit alternativen Materialien führen zu neuen Herausforderungen in der Elektronikproduktion. Für die Aufbau- und Verbindungstechnik gilt es, Anlagen und Prozesse anzupassen oder neu zu entwickeln. Diese weiterführende Optimierung erfordert innovative Strategien und neuartige Konzepte. Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene Experten aus Industrie und Forschung neue Ansätze zur Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung vor. Entlang der Prozesskette der Aufbau- und Verbindungstechnik werden aktuelle Schwerpunkte gesetzt sowie neue Herausforderungen im Umfeld der Elektronikproduktion aufgezeigt.



Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informationstransfer mit Vorträgen, ergänzenden Fachdiskussionen sowie den Vorführungen in den Labors zu präsentieren. Das Forum in der Forschungsfabrik Nürnberg im Nordostpark mit dem Labor zur Elektronikproduktion bietet Ihnen hierfür die besten Möglichkeiten. Aufgrund des vielfältigen Tagesprogramms haben Sie die Gelegenheit zur Diskussion individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen zur Aufbau- und Verbindungstechnik.

## Programm

- 09:00 **Begrüßung und Moderation**  
Rüdiger Busch, Clustermanager Nordbayern  
Cluster Mechatronik & Automation e. V., Nürnberg
- 09:05 **Leistungsfähige Fertigungskonzepte für eine innovative Baugruppenmontage**  
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke, Lehrstuhlinhaber  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- Fertigungsprozesse**
- 09:30 **Trends und Innovationen in der Bestückungstechnologie**  
Jens Deyerling, Sales Engineer  
Fuji Machine MFG. (Europe) GmbH, Mainz-Kastel
- 10:00 **Bestückung elektronischer Bauteile auf dreidimensionalen MID-Strukturen**  
Karl Görmiller, Geschäftsführer  
MID-TRONIC Wiesauplast GmbH, Wiesau
- 10:30 *Kaffeepause*
- 11:00 **Haftungsverbesserung durch Reinigung**  
Martin Königer, Prozessingenieur  
ZESTRON Europe, Ingolstadt
- 11:30 **Inspektionslösungen SPI / AOI / AXI**  
Holger Hansmann, Vertrieb Europa  
Viscom AG, Hannover
- Leistungselektronik**
- 12:00 **Integrationsmöglichkeiten von hohen Strömen in die Leiterplatte**  
Markus Wölfel, Geschäftsführer  
JUMATECH GmbH, Eckental
- 12:30 *Mittagspause*

## Programm

- 13:30 **Innovative Aufbau- und Verbindungstechnik für Leistungshalbleitermodule**  
Dr. Karsten Guth, Leiter Packaging Technologie  
Leistungsmodule, Infineon Technologies AG, Warstein
- 14:00 **Verbindungstechnik für die Leistungselektronik**  
Manfred Fahrenbach, Geschäftsführer  
EUTECH GmbH, Dusslingen
- 14:30 **Silbersintern als neue AVT in der Leistungselektronik**  
Ulrich Sagebaum, Projectleader Technology, Assembly  
SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nürnberg
- 15:00 *Kaffeepause*
- Zukünftige Herausforderungen**
- 15:30 **Zuverlässigkeitsuntersuchungen hochminiaturisierter Flip-Chip Verbindungen**  
Stefan Härter, wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 16:00 **Energieeffizienz in der Elektronikproduktion am Beispiel von Lötanlagen**  
Manfred Wolff, Area Sales Manager  
Ersa GmbH, Wertheim
- 16:30 **Prozessübergreifende Diagnose in der Elektronikfertigung**  
Dr.-Ing. Friedrich W. Nolting, geschäftsführender  
Gesellschafter diplan GmbH, Erlangen
- Abschlussdiskussion und Laborführung**
- 17:00 **Abschlussdiskussion**
- 17:30 **Laborbesichtigung**  
im Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit  
Versuchshalle, Messraum und Prüflabors